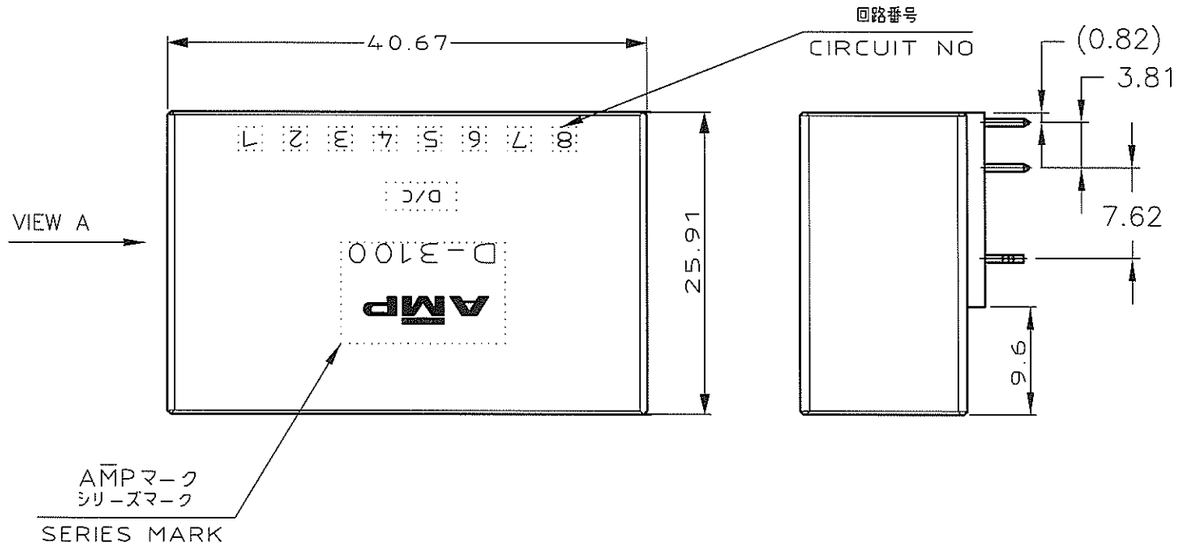
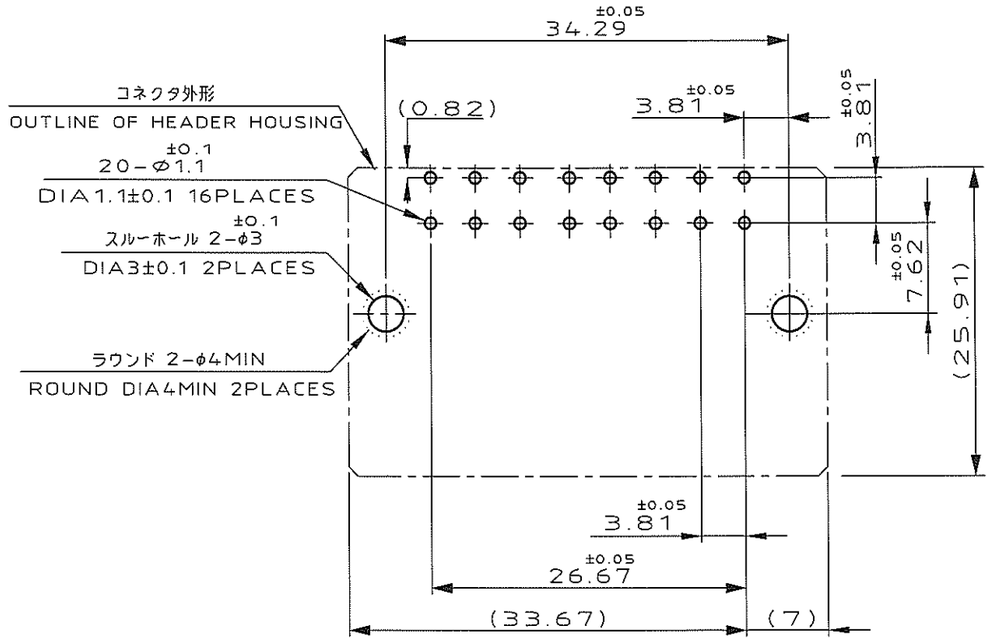
NUMBER 178307

3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

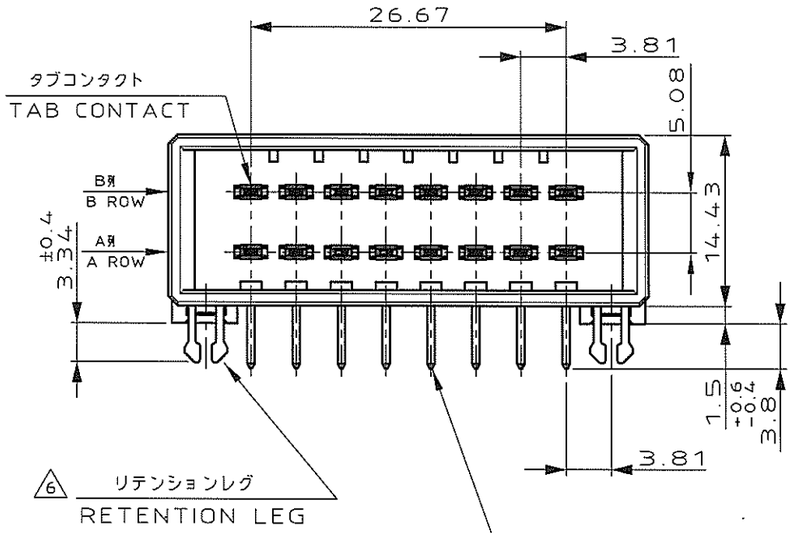


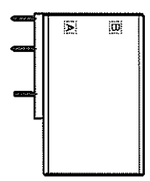


推奨基板取付け穴寸法

PC 基板厚：1.6±0.1
（非累積公差）
（コネクタ搭載面）

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)





VIEW A
(SCALE:1:1)

NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,POLYESTER COLOR:BLACK
CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:COPPER ALLOY
2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL
~~5. FINISH(RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL~~
6. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注 記

1. 材料：ハウジング：ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂　色：黒
コンタクト：銅合金
リテンションレグ：銅合金
2. めっき：コンタクト：全面Ni下地
接触部：0.38μm MIN金めっき
3. めっき：コンタクト：全面Ni下地
接触部：0.76μm MIN金めっき
4. めっき：コンタクト：全面Ni下地
接触部：2.0 μm MINスズめっき
~~5. めっき：リテンションレグとコンタクト半田付部 ：ニッケル下地の上に半田めっき~~
6. めっき　リテンションレグとコンタクト半田付部 ：ニッケル下地の上にスズめっき

6	4	178307-5
6	3	178307-3
6	2	178307-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
C2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	24MAR11

TE Connectivity

WIRE RANGE ~~mm²(AWG -)~~	INSULATION DIA ~~- mmφ~~
MATERIAL SEE NOTE 注記参照	FINISH SEE NOTE 注記参照
DR. 16/MAR/'95 K.IKEDA	DE. 16/MAR/'95 K.IKEDA
CHK. 23.MAR'95 S.MANABE	APP. 23.MAR'95 S.MANABE

NAME ダイナミック D3100 水平タイプ 16極 ヘッダーアセンブリー
16 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 ±0.3
10を超え 30以下 ±0.4
30を超え100以下 ±0.45
角度 ±3°

SIZE	LOC	NUMBER
A3	J	C-178307
SCALE 2-1	REV. C2	SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST